

ナノテクノロジープラットフォーム
研究支援に提供する設備一覧
【微細加工プラットフォーム】

機関名	設備(設備群)名	仕様	備考
大阪大学	超高精細電子ビームリソグラフィ装置	エリオニクス製 ELS-100T 加速電圧: 125keV、100keV、75keV、50keV 試料サイズ: 6inch	
大阪大学	電子ビームリソグラフィ装置	JEOL社製 JSM6500F with Beam Draw 加速電圧: 30keV 試料サイズ: 2inch	
大阪大学	集束イオンビーム装置	日立ハイテクサイエンス社製 SM12050 ステージサイズ: 2inch C銃, W銃装備, 電子銃: 500eV 加速電圧: 30keV 最小ビーム径: 4nm	
大阪大学	SEM付き集束イオンビーム装置	ZEISS社製 Nvision 40D with NPVE ステージサイズ: max 8inch Pt銃, SiO2銃装備 FE-SEMユニット, 加速電圧: 30keV 検出器: InLens, SE, Esb FIBユニット, 加速電圧: 30keV 最小ビーム径: 4nm	
大阪大学	深掘りエッチング装置	サムコ社製 RIE-400PB-NP プロセスガス: CF4, C4F8, CHF3, SF6, O2, Ar 試料サイズ: max 4inch	
大阪大学	リアクティブイオンエッチング装置	サムコ社製 RIE-10NR-NP プロセスガス: CF4, CHF3, O2, Ar 試料サイズ: max 4inch	
大阪大学	リアクティブイオンエッチング装置	サムコ社製 RIE-10NOU プロセスガス: CF4, O2, Ar, CHF3 試料サイズ: max 8inch	
大阪大学	RFスパッタ成膜装置	サンヨー電子社製 SVC-700LRF 金属成膜用RFスパッタ(Ti, Cr, W, Au, Pt等) 試料サイズ: max 4inch	
大阪大学	RFスパッタ成膜装置	サンヨー電子社製 SVC-700LRF 絶縁体成膜用RFスパッタ(SiO2, Al2O3等) 試料サイズ: max 4inch	
大阪大学	電子ビーム蒸着装置	アルバック社製 UEP-2000 OT-H/C 高真空中で一度に4種類の金属薄膜形成が可能 EB蒸着ユニット 試料サイズ: max 4inch	
大阪大学	マスクアライナー	ミカサ社製 MA-10 水銀灯250W光源(ブロード波長) 試料サイズ: max 4inch、マスク: 3inch角まで対応	
大阪大学	LED描画システム	ピーエムティー社製 PLS-1010 DLPを使用したマスクレス描画装置 CAD作図データから描画を行うので、パターン変更が簡便	
大阪大学	イオンシャワーエッチング装置	エリオニクス社製 EIS-200ER ガス: CF4, Ar, O2 ECR型イオン銃	
大阪大学	ナノインプリント装置	Obducat社製 Eitre 3 熱・UVの両方式に対応 試料サイズ: 3inch	
大阪大学	多元DC/RFスパッタ装置	キヤノンアネルバ社製 EB1100 Au, Pt, Cr成膜用 ターゲット基板間距離100~300mm可変 全自動(排気、搬送、成膜) 試料サイズ: max 6inch	
大阪大学	高精細集束イオンビーム装置 (ヘリウムイオン顕微鏡)	カールツァイス社製 ORION NanoFab Heビーム / 加速電圧30kV / 分解能0.5nm Neビーム / 加速電圧30kV / 分解能1.9nm Pt銃, SiO2銃, XeF2銃装備 試料サイズ: 45mmφ	